

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子



宏昌电子材料股份有限公司
2026 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年九月

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 180,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	募集资金拟投入金额
1	珠海宏仁年产 1,320 万张高端覆铜板、3,120 万米半固化片建设项目	106,380.37	105,500.00
2	无锡宏仁年产高端半固化片 960 万米智能化绿色化提升改造项目	10,204.00	9,500.00
3	先进封装膜材（GBF）项目	33,166.62	32,000.00
4	补充流动资金	33,000.00	33,000.00
合计		182,750.99	180,000.00

若本次向特定对象发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次向特定对象发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析

（一）珠海宏仁年产 1,320 万张高端覆铜板、3,120 万米半固化片建设项目

1、项目概况

本项目实施地点位于广东省珠海市，项目达产后可实现新增年产高端覆铜板 1,320 万张及半固化片 3,120 万米，产品主要面向 AI 服务器、数据中心、高端消费电子等市场对高阶高频高速 PCB 材料的需求。项目的实施有助于公司进一步强化“长三角+珠三角”双核心产能布局，提升区域协同及市场服务能力，同时顺应 AI 基建发展浪潮，满足下游快速增长的市场需求。

2、项目实施的必要性

（1）把握高端化发展趋势，满足下游产业升级带来的新增需求

覆铜板（CCL）及半固化片（PP）作为印制电路板（PCB）的核心基材，其市场需求与下游电子信息产业的发展趋势高度相关。近年来，随着人工智能、云计算、高速通信、智能汽车等新兴产业快速发展，电子产品对数据传输速度、信号完整性及可靠性的要求持续提升，带动高阶高频高速覆铜板及半固化片需求显著增长。尤其是在 AI 算力基础设施建设加速背景下，AI 服务器、数据中心交换设备等高端应用对 PCB 提出更高要求。AI 服务器通常采用更高层数、更高传输速率的 PCB，对低介电损耗（Df）的高速覆铜板材料需求大幅增加，其中 M4 及以上等级的高频高速覆铜板已成为 AI 服务器主板的主流选材。

本项目产品定位于高端覆铜板及配套半固化片材料领域，其中，M4 以下等级覆铜板及配套半固化片产品聚焦于高端 HDI 多层板材料，主要用于高端智能手机主板、高端消费电子、汽车电子等对线路精密度和多层化有较高要求的场景，其在线路精细度、尺寸稳定性、层间对位精度等方面要求高于常规 PCB 产品；M4 及以上等级产品则面向 AI 服务器、数据中心交换机、5G/6G 通信基站等超低损耗场景，实现高频高速信号的稳定传输。通过各类型高等级产品的差异化组合，本项目可全面覆盖从高阶消费电子到 AI 算力基础设施的多元化市场需求。

下游 PCB 市场的高增长及产品结构的持续升级，将直接拉动上游高阶覆铜板及半固化片需求持续扩大。本项目建设将围绕高阶高频高速覆铜板及半固化片，提升公司在高速、高频及低损耗材料领域的生产能力，增强对 AI 服务器、数据中心、5G/6G 通信等高增长领域客户需求的保障能力，顺应覆铜板行业高端化发展趋势，进一步提高公司市场竞争力。

（2）完善长三角与珠三角双基地战略布局，提升区域协同及市场服务能力

长三角和珠三角是我国电子信息产业及 PCB 产业最为集中的两大区域，聚集了大量 PCB 制造企业及服务器、通信设备、消费电子、汽车电子等终端产业链企业。目前无锡宏仁和珠海宏仁均已成为公司覆铜板及半固化片的重要生产基地，其中，珠三角作为 PCB 产业集群的核心城市群之一，集中

了多家在 AI 服务器、通信设备、高端消费电子领域具有重要影响力的 PCB 龙头企业，拥有完善的上下游配套体系和丰富的客户资源，其对于高阶高频高速覆铜板及半固化片的需求持续增长，对供应商的交付能力、响应速度及供应稳定性亦提出更高要求。公司目前在珠三角地区的高阶覆铜板及半固化片产能布局尚不能满足区域客户快速增长的需求。

目前公司无锡基地与珠海基地已经形成“长三角+珠三角”双核心产能布局，本项目拟在珠海基地实施扩产，进一步强化双基地布局。一方面，两大基地可分别就近覆盖国内两大 PCB 产业集群，提升对区域客户的供应保障能力和交付效率，增强客户合作黏性；另一方面，通过生产资源、客户资源及供应链资源的跨区域协同配置，公司能够优化整体产能布局，提高运营效率，增强面对市场需求波动的灵活性和抗风险能力。通过构建覆盖国内核心电子产业区域的生产网络，公司将进一步提升高阶高频高速覆铜板及半固化片市场竞争力，为业务规模扩大及市场份额提升提供有力支撑。

3、项目实施的可行性

（1）产业政策持续利好，项目发展方向与国家战略高度契合

近年来，国家持续出台一系列产业政策，积极推动电子信息产业及先进材料产业发展，为高性能覆铜板等电子元器件关键材料的发展提供了良好的政策环境。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出，完善新型举国体制，全链条推动集成电路、先进材料等领域关键核心技术攻关取得决定性突破。

2023 年 12 月，国家发展和改革委员会发布《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，将“高性能覆铜板”等电子元器件生产专用材料列入鼓励类产业，为电子材料产业发展提供政策支持。2025 年 8 月，工业和信息化部、国家市场监督管理总局联合发布《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》，提出提升电子信息制造业产业链供应链韧性和安全水平，持续提升关键核心技术能力，推动电子信息制造业高质量发展。

此外，《电子信息制造业数字化转型实施方案》《关于推动未来产业创新

发展的实施意见》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等政策文件，进一步明确了电子信息、新材料等产业的发展方向。上述政策的实施将持续促进电子信息产业升级和关键电子材料国产化发展，为本项目实施提供良好的政策保障。

(2) 技术经验与市场资源双轮驱动，本项目具备成熟的内外部实施条件

公司已在珠海通过“功能性高阶覆铜板电子材料建设项目”完成一期生产基地建设，并已顺利投产运营，充分验证了产线工艺的成熟性与设备运行的稳定性，积累了覆盖生产全流程的丰富实操经验。本项目为珠海基地扩产项目，将充分依托一期项目已形成的成熟工艺技术体系与运营管理经验，共享现有供应链渠道与客户认证资源，有效降低新增产能的市场导入成本，确保新增产能能够快速转化为实际产销量。同时，本项目将进一步强化公司“长三角+珠三角”双核心产能布局，实现产能的区域协同与灵活调配。公司已具备坚实的技术基础与管理保障，为项目实施提供了充分的内部条件。

从外部市场来看，据 Prismark 数据，2025 年中国大陆 PCB 产值达到 489.69 亿美元，占全球 PCB 市场份额超过 50%，预计 2030 年中国 PCB 市场规模将达 685.35 亿美元，2025 年至 2030 年复合增长率为 7.0%，预计未来几年我国 PCB 产业将保持稳定增长态势。珠三角地区是我国 PCB 产业规模最大、产业链最为完善的区域，珠海基地位于珠三角核心区域，可就近覆盖区域内 PCB 产业集群。公司凭借长期积累的市场信誉和稳定可靠的产品品质，已与区域内多家大型 PCB 客户建立长期稳定的合作关系，珠海基地在物流配送效率、技术服务响应速度等方面具备显著的区域竞争优势，可有效满足珠三角地区客户对高阶覆铜板快速交付和本地化配套的需求。广阔的区域市场空间与优质的客户资源储备，为本次新增产能的消化提供了充分的市场保障。

4、项目投资概算

本项目总投资 106,380.37 万元，拟使用募集资金投入 105,500.00 万元。

5、项目选址及实施主体

本项目实施地点位于广东省珠海市金湾区，实施主体为珠海宏仁电子材料科技有限公司，系发行人全资孙公司。

6、项目的经济效益评价

项目达产后，公司将提升高端覆铜板及半固化片产品生产能力，预计可为公司带来良好的经济效益。

7、项目的用地、立项、环评报批事项

截至本报告公告日，本项目所涉及环评及备案等手续正在办理中，相关备案审批程序的办理预计不存在实质性障碍。本项目建设需新增用地，相关土地使用权正在获取中。

（二）无锡宏仁年产高端半固化片 960 万米智能化绿色化提升改造项目

1、项目概况

本项目实施地点位于江苏省无锡市，项目达产后可实现新增年产高端半固化片 960 万米。本项目产品覆盖 HDI 板至 M8 全系列 PCB 所需半固化片，可适配 AI 服务器、数据中心、消费电子等高端市场需求。本项目的实施将有效提升各规格高端半固化片产品的产能储备，巩固并提升公司在高端 PCB 材料市场的竞争地位，同时向产线智能化、产品绿色化、用电清洁化以及环保设施完善化方向发展，提升公司可持续发展能力。

2、项目实施的必要性

（1）AI 算力产业高速发展，高端半固化片市场需求持续放大

通信技术的每一次升级，都意味着信号频率的持续提高与传输速度的不断加快，对半固化片材料的介电性能提出了更为严苛的要求。随着 5G 向 5.5G、6G 演进，以及 AI 算力基础设施的快速部署，PCB 基材正从传统 FR-4 材料向高频高速、超低损耗方向全面升级，高端半固化片材料在高阶覆铜板中的价值占比持续提升，市场空间持续扩大。高频高速低损耗的性能要求亦同步推动上游电子布、铜箔、树脂等关键原材料向更高性能方向迭代升级。据 Prismark 数据，

2025 年服务器及存储相关 PCB 产值为 156.75 亿美元，2030 年相关 PCB 产值将达 346.79 亿美元，2025-2030 年复合增长率约 17.2%。

AI 服务器对半固化片需求的拉动，不仅体现为 PCB 整体市场扩容，更体现为单位 PCB 产品中半固化片用量的结构性提升。一方面，AI 服务器 PCB 层数远高于普通服务器产品，据 Prismark 数据，普通服务器 PCB 层数多为 8-16 层，AI 板普遍在 22 层以上，高端型号层数可达 78 层，未来向 80 层以上迭代，高多层结构对半固化片等层间粘接材料的需求量呈数倍增长。另一方面，AI 服务器大量采用任意层 HDI 结构，需通过多层极薄 PP 叠压来实现精密盲孔和阻抗控制，进一步推升了单位面积内的 PP 用量。在此背景下，高阶高频高速覆铜板用半固化片作为 AI 服务器、数据中心等高阶 PCB 的关键配套材料，其市场需求正伴随 AI 算力产业的蓬勃发展而持续放大。

(2) 布局高端半固化片产品产能，把握 PCB 基材升级机遇

在发展过程中，公司紧密跟踪行业及市场在高速材料方面的需求，持续开展无卤型高速材料的开发、优化及推广工作。积极配合下游终端测试及 PCB 客户材料认证需求，加速高端产品的市场导入。目前公司已构建覆盖 M4 以下至 M8 等级的全系列高速半固化片产品体系，其中 M4-M8 等级高阶产品已通过多家头部 PCB 客户认证，部分型号已实现批量供应。

高速 HDI 用半固化片产品为公司核心产品之一，报告期内产能利用率处于较高水平，面对不断扩大的高端消费应用市场需求，公司亟需通过扩产保障供货能力，保障现有业务稳健发展；与此同时，M4 及以上等级高阶产品的市场需求正伴随 AI 算力基础设施的快速部署而爆发式增长，公司需布局高阶产品产能储备，以承接日益增长的高端市场需求。目前公司已实现 M6、M7 及 M8 等级产品出货，本次项目的实施有助于公司进一步优化产能结构，巩固并提升公司在高端 PCB 材料市场的竞争地位。

3、项目实施的可行性

(1) 半固化片专项技术积淀深厚，技改扩产具备技术基础

无锡宏仁作为公司覆铜板及半固化片的重要生产基地，在半固化片领域深耕多年，积累了深厚的技术积淀与丰富的量产经验。在高速半固化片领域，公

司通过对材料基本性能优化、PCB 加工性能优化及 PP 储存性能优化，实现了压合流胶性能优化和超低介电损耗的兼顾，相关技术已应用于 GA-686（M6）、GA-688（M8）系列等高频高速覆铜板产品。

在工艺控制方面，无锡基地现有产线长期稳定运行，积累了丰富的工艺参数数据库和品控经验，在半固化片的树脂含浸均匀性、粘度控制及其它性能稳定性精准控制等关键工艺环节形成了核心技术能力。本次技改扩产将基于无锡基地成熟的技术体系和工艺积淀进行产线升级，可大幅降低技术导入风险，缩短产能爬坡周期，确保新增产能快速达产达效，为本项目的顺利实施提供了充分的技术保障。

（2）优质的客户资源及产品，为项目新增产能消化提供市场保障

随着电子信息产业向高性能方向发展，公司围绕高端应用领域持续推进产品研发与技术升级，已成功开发并优化多个系列覆铜板及半固化片产品。在高速材料研发与认证方面，无锡宏仁 GA-686、GA-686N 等系列已进入 AMD 及 Intel 终端材料库，并持续参与 Intel 华山案等测试项目。在国内终端客户拓展方面，2024 年开始，无锡宏仁高速材料 GA-686、GA-686N 启动华勤技术、中科可控、安擎计算机等国内终端客户材料测试，2025 年陆续通过电性及信赖性测试并进入材料库，同时参与安擎计算机多个服务器项目材料测试，并取得量产订单。在半固化片产品线上，公司同步提供与高频高速覆铜板配套的半固化片产品，为客户提供完整的高频高速材料解决方案。

目前，公司一方面持续深化与现有 PCB 客户的合作关系，不断提升公司高速材料在下游客户中的认可度和影响力；另一方面积极拓展在服务器及 AI 算力领域具有较强影响力的 PCB 厂商，并已启动材料测试认证工作，持续推广公司高频高速材料及配套半固化片产品。上述优质客户资源的持续积累与不断拓展，为本次募投项目新增半固化片产能的消化提供了充分的市场保障。

4、项目投资概算

本项目总投资 10,204.00 万元，拟使用募集资金投入 9,500.00 万元。

5、项目选址及实施主体

本项目实施地点位于江苏省无锡市新吴区，实施主体为无锡宏仁电子材料

科技有限公司，系发行人全资子公司。

6、项目的经济效益评价

项目达产后，公司将提升高端半固化片产品生产能力，预计可为公司带来良好的经济效益。

7、项目的用地、立项、环评报批事项

截至本报告公告日，本项目所涉及环评及备案等手续正在办理中，相关备案审批程序的办理预计不存在实质性障碍。本项目实施不涉及需要新增取得土地的情况。

（三）先进封装膜材（GBF）项目

1、项目概况

本项目拟新建先进封装膜材规模化产线，依托 GBF 产品技术优势以及“电子级树脂-覆铜板-先进封装膜材”一体化协同，拓展 1.6T 及以上高速光模块、AI 服务器主板等先进封装市场。项目旨在抓住 AI 快速发展窗口期，实现高端封装膜材产品快速发展，进而优化公司产品结构，满足公司长期发展战略。

2、项目实施的必要性

（1）提升先进封装膜材产业化能力，提高产业链国产化水平

面对高速光模块、AI 服务器主板、CoWoP 先进封装等高端 AI 应用场景持续升级的材料需求，行业内积极探索高性能的核心绝缘介质材料方案。公司 GBF 先进封装膜材为特种环氧及高频高速碳氢树脂基膜材，产品能够满足超细线宽/线距、超低损耗、无玻纤效应、低翘曲等高性能应用要求，面向 1.6T 及以上高速光模块类载板、AI 服务器主板等 UHDI 超高密度 PCB 的高性能要求，产品可在超薄基材上实现微米级精细布线，满足多阶微孔、多层堆叠制程需求，在对高速互连要求严苛的场景具有广阔应用前景。

当前先进封装膜材领域呈现高度寡头垄断格局，日系头部企业依托数十年技术积淀、完整专利壁垒与成熟稳定量产体系占据绝大部分市场份额。在此竞争格局下，国内载板、封测及高速光模块等产业采购高度依赖海外供应链，面临交付周期长、成本波动、供应链安全等风险。目前国内厂商在该类高端封装

材料仍处于早期阶段，整体国产化供给规模偏低，尚未形成可匹配下游大规模订单的稳定量产能力。

通过本次募投项目实施，公司拟新建年产 384 万平方米先进封装膜材（GBF）产能，打造高端膜材规模化生产基地，为先进封装用高阶类载板等提供介质国产化路径，助力提高国内算力产业链自主性。

（2）把握市场快速发展机遇，深化新材料产业布局

高频高速光模块、高端 AI 服务器等领域对互连密度、高频信号完整性、低翘曲可靠性要求大幅提升，业内诸多材料方案面临玻纤效应、高频信号损耗、热膨胀失配翘曲等现实技术瓶颈。当前海外高端封装膜材产能建设周期长，供给释放速度难以匹配国内算力及高速光互联产业持续增长的需求，为国内具备差异化技术路线的材料企业开辟出广阔的市场替代空间。本项目 GBF 膜材产品的应用可有效降低玻纤效应，实现信号零时序偏移，同时具备超低介电损耗、低翘曲等突出性能优势，可缩短信号传输路径、降低综合制造成本，适配国内先进封装全链条国产化闭环的发展诉求。

通过本项目的实施，公司可形成稳定批量供货能力，面向高速光模块厂商、先进封装产业持续释放的增量采购需求，充分把握行业增长红利与国产产品发展窗口期，依托差异化成套解决方案抢占高端封装膜材市场空间，进一步丰富公司在新材料领域的产业布局。

（3）依托自身树脂产业链优势，落实公司长期战略发展目标

公司长期深耕电子级树脂赛道，具备完整的树脂材料研发及规模化生产配套能力。公司先进封装膜材（GBF）的核心基材为特种环氧及高频高速碳氢树脂基膜材，可根据下游需要通过树脂涂覆铜箔等多种产品形式面向下游客户销售。本项目的实施将进一步完善公司“电子级树脂-覆铜板-先进封装膜材”的一体化产业布局。依托自研产业链协同优势，公司可拓展高速光模块、AI 服务器主板等先进封装应用场景，开展特种树脂、覆铜板、先进封装膜材等一体化协同开发，伴随着下游产品迭代升级定向开展方案设计与配方迭代。

项目建成后，公司先进封装膜材（GBF）将实现规模化供应，能够有效提高高附加值新材料业务占比。从公司发展战略角度，本募投项目是公司产品结

构升级、深化高速光模块、AI 服务器主板等高端市场布局的重要落地载体，是落实公司长期发展战略的重要举措。

3、项目实施的可行性

(1) 项目与公司现有主营业务深度协同，产业配套体系完备

公司深耕电子级树脂、覆铜板材料制造领域多年，在树脂材料领域现已形成覆盖树脂合成、配方改性、理化检测的完整生产制造体系，相关合成装置、提纯单元、理化研发实验室可实现复用。针对高端应用场景，公司可基于现有树脂平台开展定向分子设计与配方迭代，从源头实现原材料供应、批次品质一致性管控，规避上游原料价格、交付波动风险。同时，珠海基地坐落于珠三角电子产业集群核心，毗邻诸多国内头部 PCB 企业，物流配套完善，可快速响应下游客户样品、批量供货需求。公司树脂及覆铜板业务积累的工艺经验可迁移至 GBF 膜材制造，能够快速响应下游客户样品试制以及批量供货需求。

客户拓展层面，公司高端覆铜板及半固化片产品用于高速 PCB 生产，公司下游客户中多家头部 PCB 厂商正积极布局 UHDI 超高密度 PCB、CoWoP 封装类载板等业务，并存在持续的技术迭代升级需求。随着终端产品技术要求不断提高，先进封装膜材（GBF）在下游应用不断深化，公司可依托现有客户资源完成产品验证，可有效降低市场开拓成本、缩短导入周期，实现对客户高端 AI PCB 业务的一体化材料配套，强化客户粘性，为本项目产能消化筑牢市场基础。

综上，本项目可充分复用现有业务资源，为规模化量产落地提供坚实保障。

(2) 本项目具备成熟的技术储备，市场前景广阔

公司持续配合下游客户需求，开发最新增层膜材料，持续推进产品的系列化和产业化，推动产品在下游及终端客户的认证与应用。目前，公司已完成 GBF 商标注册，累计取得多项高频、低介电树脂配套发明专利，产品在消除玻纤时序偏移、介电损耗控制、耐湿热稳定性、精细线路加工能力方面形成差异化优势，可适配超细线宽/线距、超低损耗、无玻纤效应、低翘曲等高性能应用要求。在 1.6T 及以上高速光模块、AI 服务器主板、CoWoP 先进封装等领域，行业内正在加快产业化节奏，公司下游诸多 PCB 厂商也在布局相关高端产品，GBF 膜材未来预计具有较好的市场前景。

（3）公司人才梯队储备完善，项目实施具备充足人才可行性

公司发展多年来已针对电子级树脂、覆铜板材料制造领域搭建起覆盖研发、生产工艺、品质管控、供应链管理的完整内部人才体系，现有主业人才可直接为本项目复用，形成协同效应。公司树脂研发团队长期从事树脂材料配方开发，深度掌握 GBF 膜材核心基体原料的分子设计、提纯改性技术，可同步支撑新型膜材配套树脂迭代优化。公司现有生产管理团队拥有深厚的高标准量产实操经验，熟悉恒温恒湿无尘生产管控及电子基材生产工艺，可降低本项目人员培养周期与人力成本。此外，公司持续针对先进封装材料领域定向培育及引进高端专业人才，专职负责 GBF 材料和完整方案的迭代优化、下游客户认证对接、成套方案技术支持，人才梯队储备完善，项目实施具备充足人才可行性。

4、项目投资概算

本项目总投资 33,166.62 万元，拟使用募集资金投入 32,000.00 万元。

5、项目选址及实施主体

本项目实施地点位于广东省珠海市金湾区，实施主体为珠海宏昌电子材料有限公司，系发行人全资子公司。

6、项目的经济效益评价

项目达产后，公司将提升先进封装膜材（GBF）产品生产能力，预计可为公司带来良好的经济效益。

7、项目的用地、立项、环评报批事项

截至本报告公告日，本项目所涉及环评及备案等手续正在办理中，相关备案审批程序的办理预计不存在实质性障碍。本项目建设需新增用地，相关土地使用权正在获取中。

（四）补充流动资金

公司拟将本次募集资金中的 33,000.00 万元用于补充流动资金，满足公司日常生产经营资金需求，进一步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力。

近年来，公司业务经营规模不断扩大，营运资金需求持续增加。通过本次募集资金补充流动资金项目的实施，能够有效缓解公司未来可能面临的资金支

出压力，确保业务发展的顺畅进行，并对于增强公司抵御市场风险的能力、降低资产负债率、增强流动性、提升公司综合竞争力以实现既定的战略规划均具有重要意义。

目前，世界各国及地区均面临宏观经济波动等风险因素，公司亟需通过增加流动资金来增强自身的资金储备，进而优化财务结构，减少财务成本，同时提升公司对各种风险的抵御能力，为公司的长远发展奠定坚实的财务基础，确保可持续性的稳健运营。本次发行的募集资金用于补充流动资金项目，符合公司当前的实际发展情况，有利于增强公司的资金实力，提高公司的抗风险能力，实现公司健康可持续发展。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略的发展方向，与公司现有主营业务密切相关，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目的实施是公司正常经营的需要，有助于公司抓住行业发展的机遇，巩固和提高公司在行业内的市场地位和市场影响力，符合公司长期发展需求及股东利益。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后，公司的资产总额与净资产总额将同时增加，能够有效增强公司的资金实力，为公司业务发展提供有力保障。

本次募集资金投资项目具有良好的经济效益。本次发行募集资金到位后，由于募投项目的投入需要一定的周期，短期内公司净资产收益率等财务指标可能存在下降的风险。随着公司募投项目建设完毕并逐步释放效益，公司的盈利能力将进一步增强，公司整体的业绩水平将得到进一步提升，为公司股东贡献回报。

四、募集资金投资项目可行性结论

综上所述，本次募集资金使用用途符合未来公司整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金投资项目的实施，

将进一步扩大公司业务规模，提升公司整体竞争实力，有利于公司可持续发展，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合全体股东的利益。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日